2-取代苯并咪唑在铜表面的成膜过程研究

沈 建 庞正智 余鼎声 卢艳华 王 磊 (北京化工大学材料科学与工程学院,北京 100029)

摘 要:通过 XPS,紫外等方法研究了 2-取代苯并咪唑在铜片表面成膜的过程。2-取代苯并咪唑首先与表面铜原子配位成键形成第一层膜,然后通过一价铜离子与 2-取代苯并咪唑成键来完成膜的增长。

关键词: 2-取代苯并咪唑;成膜;铜

中图分类号: TQ252.3

引言

苯并咪唑化合物是两性物质,既可接受质子,也可解离出质子。当解离质子后,由于电子云离域共轭的形成,1位N原子与3位N原子具有同样的配位活性[1],极易与金属发生配位反应。因此该类化合物常被用作金属的表面处理剂,形成一层极薄的保护膜,赋予金属表面优异的抗氧化性、耐热性、绝缘性等性能。

国内外对于咪唑类化合物在铜表面作用过程的研究很多。Ching fawu等利用成键键能的变化确定膜为 Cu()的配合物^[2]; C. McCROR YJOY等认为膜中存在 Cu()和 Cu(),但首先是 Cu()与咪唑类化合物络合,然后一部分 Cu()络合物被氧化为 Cu()络合物,而 Cu()本身不能与之配位^[3]; V. Sirtori等则认为膜中根本没有 Cu()参与配位^[4]。通过 XPS等检测手段,大部分研究者都认为表面膜是咪唑类化合物与 Cu()的配合物^[5-8]。本文通过 2-苄基苯并咪唑在铜表面的成膜实验对成膜过程进行了进一步的探索。

1 实验部分

1.1 实验仪器及药品

pHS-25 精密酸度计,上海雷磁仪器厂;超级恒温水浴,上海雷磁仪器厂;UV-260 紫外光谱仪,日本岛津公司;X 射线光电子能谱仪,Sigma Probe,

收稿日期: 2004-01-05

基金项目: 教育部重点项目(MKPT-02-176)

第一作者: 男,1979 年生,硕士生 E-mail: shenjiandydf@sohu.com ThermoV G Scientific 公司生产,Mg 靶 1 253.6 eV, 功率 200 W;甲酸(无水),分析纯,北京化学试剂公司;乙酸,分析纯,北京益利精细化学品有限公司;硫酸、盐酸,分析纯,北京化工厂;30 %双氧水,分析纯,江阴市化学试剂厂;氯化铜,分析纯,北京红星化工厂。2-苄基苯并咪唑为本实验室自行合成,所用水均为去离子水。

1.2 实验方法

- 1.2.1 成膜 分别配制无铜和溶有一定浓度 Cu ()离子 2-苄基苯并咪唑成膜液;铜片经打磨 水洗 除油 微蚀 酸洗等处理后成膜,成膜温度为 40~50 .成膜时间 30~90 s。
- 1.2.2 膜厚测量 用 $25 \, \text{mL} 5 \, \%$ 稀盐酸将铜片 ($30 \, \text{mm} \, \mathbf{x} 50 \, \text{mm}$) 上的膜溶解 ,经 UV-260 紫外光谱仪测定波长为 $270 \, \text{nm}$ 附近的最大吸光度 ,测定前将装有原成膜液的方型试管安装在待测位置上 ,把光度计的吸光度值归零。按公式 (膜厚 (μm) = 吸光度 $A \, \mathbf{x} 0.64 \, (\mu \text{m})$) 计算膜厚。其中 $0.64 \, \mu \text{m}$ 为原成膜液皮在铜片所成膜的理论值。
- 1.2.3 铜的价态测定 铜片(10 mm ×10 mm)按相 应方式处理后经 X 射线光电子能谱仪测试 Cu2p 及 CuA 峰。

2 结果与讨论

2.1 膜厚

经 Cu() 成膜液和无铜成膜液处理后,样品的紫外吸收如图 1,2。在 276.3 nm 处均出现最大吸收,这是 2-取代苯并咪唑与铜配合物的吸收峰位。由公式计算得出,铜片在 Cu()成膜液中处理后膜厚为 0.22 µm,在无铜成膜液中处理后为 0.20 µm。两种样品膜厚相差不多,说明成膜液中 2-取代苯并

咪唑能否在铜片上成膜并非取决于成膜液里有无 Cu()的存在。显然,膜的增长不是靠 2-取代苯并 咪唑与 Cu()配位,即使在 Cu()成膜液中,Cu()也没有进入膜中。

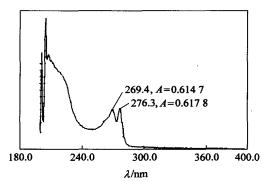


图 1 Cu())成膜液成膜样品紫外谱图 Fig. 1 Ultraviolet graph of phragmoid sample treated by Cu() solution

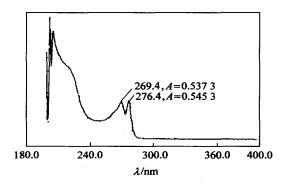


图 2 无铜成膜液成膜样品紫外谱图 Fig. 2 Ultraviolet image of phragmoid sample treated by solution without copper

2.2 价态

· 54 ·

在以上两种成膜液中处理过的铜片,经 XPS测试结果如图 3,4。由图可知,Cu2p 电子能谱在高能端均缺乏伴峰,说明铜的价态不是二价。一价铜与零价铜在 Cu2p 电子能谱上难以分辨,但其俄歇峰有明显的差别。零价铜的俄歇峰出现在 918.0 eV附近,一价铜则在 916.0 eV 附近或以下出峰。图 3,4 中俄歇峰位置在 914.0 eV 附近,说明经两种成膜液处理后,膜中均为一价铜。

在 Cu() 成膜液里形成的膜中出现了 Cu(),显然表明溶液中的 Cu()本身并没有进入膜中。此前有研究者称膜中 Cu()是由于溶液中 Cu()与铜片表面的 Cu(0)发生了反应^[8],但这种反应只会在裸铜表面发生,当铜片表面形成第一层膜后,固相 Cu(0)与溶液中 Cu()已不能接触,因此

在后续的膜中将不会出现 Cu()。而铜片经无铜成膜液处理后,膜中同样出现 Cu(),这就进一步证明,Cu()的来源与 Cu()无关。

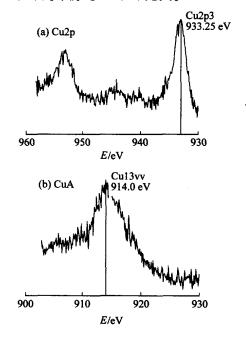


图 3 铜片经 Cu()成膜液处理后的 Cu2p 及 CuA Fig. 3 Cu2p(a) and CuA(b) graphs of copper after treated by Cu() solution

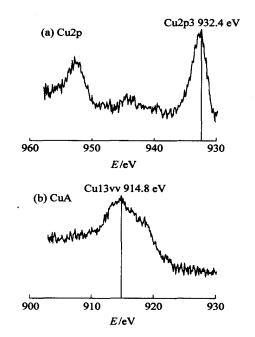


图 4 铜片经无铜成膜液处理后的 Cu2p 及 CuA Fig. 4 Cu2p (a) and CuA(b) graphs of copper after treated by solution without copper

尽管铜片在没有任何处理前,表面上大部分是 Cu₂O,但经打磨,微蚀,酸洗等处理后,氧化层已基 本除去。本实验铜片成膜厚度 0.2 µm 左右,而 XPS 的最大探测深度只有 10 nm,因此 XPS 对膜中铜价态的探测并不会受到铜片基板上有无氧化层的影响。由于成膜体系中存在有机酸,且成膜在开放的条件下进行,因此膜中一价铜可能来至铜片受到的有机酸的腐蚀或空气的氧化。

3 结论

2-取代苯并咪唑首先与铜片上的铜原子配位形成第一层膜;膜的增长是靠一价铜与咪唑化合物逐层配位而实现的。

参考文献

- [1] 赵永生,史志龙,庞正智.铜表面 2-芳基苯并咪唑铜配合物膜结构及其热稳定性研究[J].材料保护,2003,36(4):29-31
- [2] Wu Chingfa, Chen Wenyin, Junnfwulee. Microcalorimetric studies of the interactions of imidazole with immobilized Cu(): Effects of pH value and salt concentration[J]. Colloid Inter Sci, 1996, 180(1):135 -

143

- [3] McCROR Y-Joyc, Rosamiliajm. Modification of the electrochemical behavior of copper by azole compounds [J]. Electroanal Chem, 1982, 136(3):105 - 118
- [4] Sirtori V, Lombardi L, Redaelli G. Chemical composition and thermal stability of 2-butyl-5-chloro-benzimidazole film [J]. Journal of Electronic Materials, 1997, 26 (5):115-123
- [5] Poling G.W. Reflection infrared studies of film formed by benzotriazole on copper[J]. Corros Sci , 1970 ,172 (10) : 359-368
- [6] Kester J J, Furtak T E, Bevolo A J. Surface enhanced Raman scattering in corrosion science: Benzotriazole or copper[J]. Electrochem Soc, 1982,129(15):1716-1723
- [7] Huynh N, Bottle S E, Notoya T, et al. Inhibitive action of the octyl esters of 4-and 5-carboxybenzotriazole for copper corrosion in sulphate solutions[J]. Corrosion Science, 2000, 42:259 - 274
- [8] 张贝克,陈文禄,庞正智. 咪唑化合物在金属铜上形成 表面膜的可焊性研究[J]. 北京化工大学学报,2000, 27(3):40-42

Formation of 2-subsituted benzimidazole film on copper surface

Shen Jian Pang Zheng-zhi Yu Ding-sheng Lu Yan-hua Wang Lei (College of Materials Science and Engineering, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China)

Abstract: The process of 2-substituted benzimidazole forming film on copper surface was investigated through XPS and UV. The first layer of the film was formed by 2-substituted benzimidazole coordinating to Cu(0) on the copper surface. The next a few layers formed due to 2-substituted benzimidazole on the film coordinating to Cu().

Key words: 2-subsituted-benzimidazole; film; copper

(责任编辑 朱晓群)

本刊成为我国三大中文科技期刊检索系统"核心期刊"

继科技部中国科学技术信息研究所、中科院文献情报中心之后,《北京化工大学学报》(自然科学版)又被北京大学图书馆列为核心期刊。

到目前为止,本刊已成为我国三大中文科技期刊检索系统的核心期刊。